

Title (en)

Method for coating a mould body used in a continuous casting machine

Title (de)

Verfahren zum Beschichten eines in einer Stranggiessanlage eingesetzten Kokillenkörpers

Title (fr)

Procédé pour revêtir une lingotière d'une machine de coulée continue

Publication

EP 1520643 A1 20050406 (DE)

Application

EP 04021767 A 20040914

Priority

DE 10345865 A 20031001

Abstract (en)

Process for coating a Cu or Cu alloy chill mold body (1) in an extrusion process where the chill mold is coated at least partially with an inner Cr coating, where a cermet wear resistant layer is applied to the Cr coating by thermal spraying, and has a layer hardness differing by a factor of 0.6-2 from that of the inner layer. An independent claim is included for a Cu or Cu alloy chill mold of an extrusion unit as described above.

Abstract (de)

Ein Kokillenkörper (1) einer Stranggießanlage aus Kupfer oder Kupferlegierung ist zumindest teilweise mit einer Innenbeschichtung aus Chrom versehen. Auf die Innenbeschichtung wird mittels eines thermischen Spritzverfahrens eine Metall-Keramik-Verschleißschuttschicht aufgebracht, deren Schichthärte sich um einen Faktor 0,6 bis 2 von der Schichthärte der Innenbeschichtung unterscheidet. Das Auftragen der Metall-Keramik-Verschleißschuttschicht erfolgt durch das robotergesteuerte Führen eines Beschichtungskopfes entlang einer definierten Steuerkurve (5). <IMAGE>

IPC 1-7

B22D 11/059; C23C 4/02

IPC 8 full level

B22D 11/059 (2006.01); **C23C 4/02** (2006.01); **C23C 4/06** (2006.01); **C23C 4/12** (2006.01); **C23C 4/18** (2006.01)

CPC (source: EP)

B22D 11/059 (2013.01); **C23C 4/02** (2013.01); **C23C 4/06** (2013.01); **C23C 4/12** (2013.01); **C23C 4/18** (2013.01)

Citation (applicant)

- JP H01233047 A 19890918 - NOMURA TOKIN KK
- JP H10230348 A 19980902 - MISHIMA KOSAN CO LTD, et al

Citation (search report)

- [Y] WO 9821379 A1 19980522 - MONITOR COATINGS & ENG [GB], et al
- [A] EP 0774525 A1 19970521 - NGK INSULATORS LTD [JP]
- [A] US 5958520 A 19990928 - COOK DAVID JAMES [US], et al
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 14 31 December 1998 (1998-12-31)
- [XY] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0135, no. 60 (M - 906) 13 December 1989 (1989-12-13)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0081, no. 80 (M - 318) 18 August 1984 (1984-08-18)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0132, no. 44 (M - 834) 7 June 1989 (1989-06-07)

Cited by

WO2008086862A1; CN111893416A

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1520643 A1 20050406; EP 1520643 B1 20091028; AT E446813 T1 20091115; DE 10345865 A1 20050421; DE 502004010290 D1 20091210

DOCDB simple family (application)

EP 04021767 A 20040914; AT 04021767 T 20040914; DE 10345865 A 20031001; DE 502004010290 T 20040914